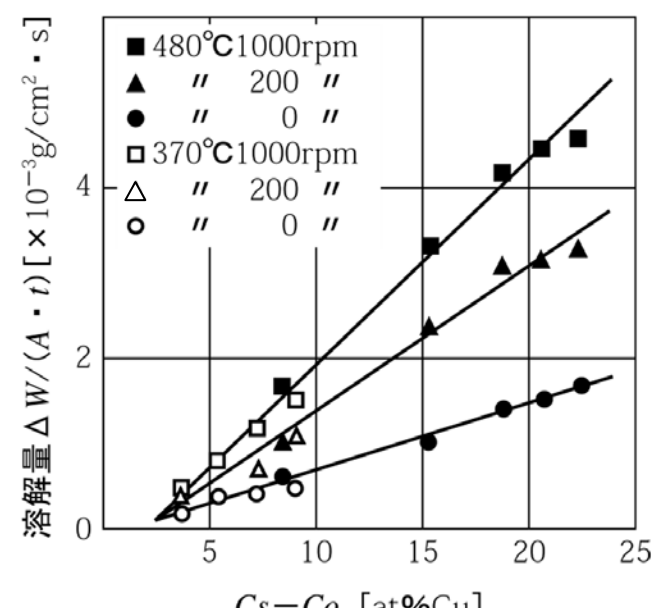
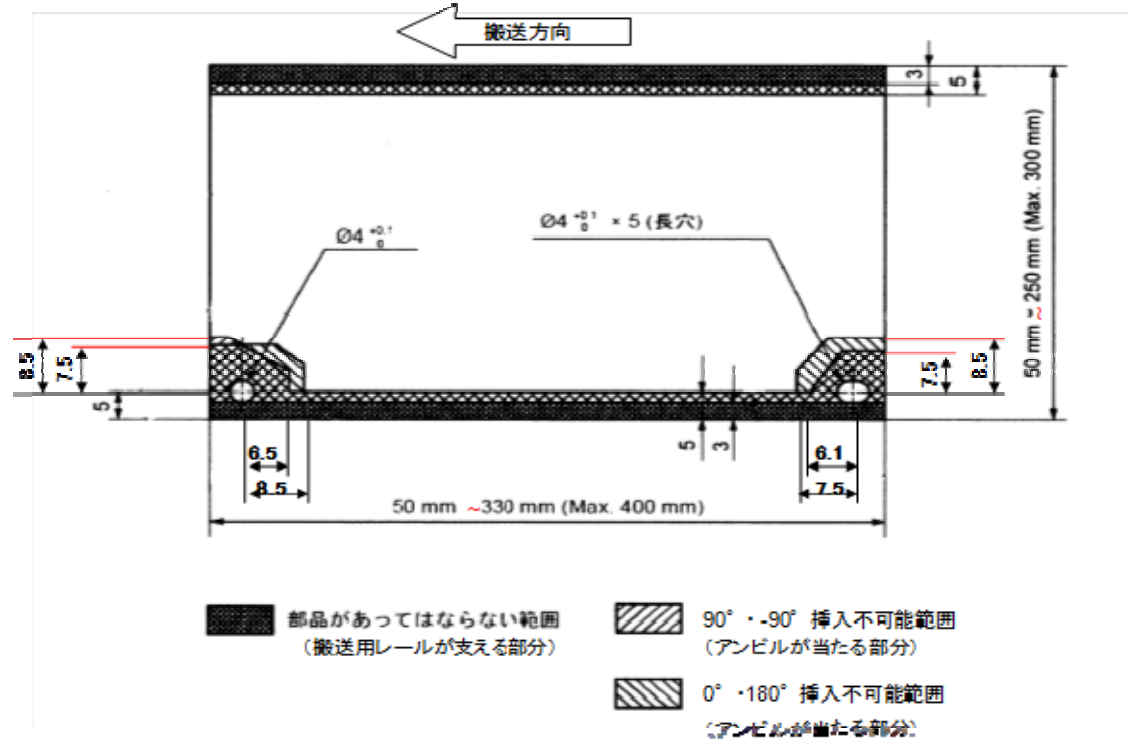
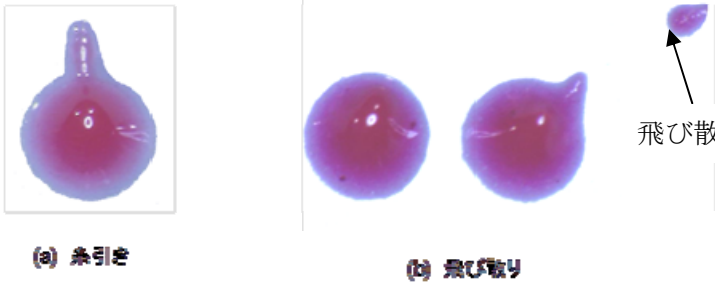
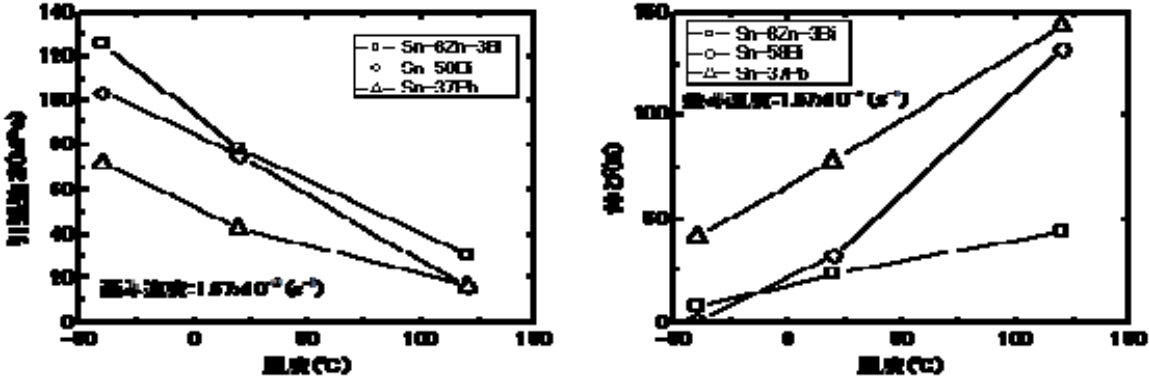


## 標準マイクロソルダリング技術 第3版 正誤表

頁	訂正箇所とその説明
7	<p>図 1.3.2 右上 フォトレジスト塗布の図 シリコン基板を追加</p> <p>図1.3.2 リソグラフィーを用いた加工の一例</p>
11	<p>表 1.4.1 QFP の特徴の説明文 誤 : <u>I</u>字形に成形されたパッケージ → 正 : <u>J</u>字形に成形されたパッケージ</p>
12	<p>図 1.4.2 パッケージの断面構造 (C) FC-BGA の図 線を追加</p> <p>(c) FC-BGA</p>
33	<p>表 2.2.1 線膨張係数の単位 誤 : <math>10^{-4}/K</math> → 正 : <math>10^{-6}/K</math></p>
51	<p>本文右段下から 3 行目の参考文献番号 誤 : 影響を示したものである 19. → 正 : 影響を示したものである 19.</p>

頁	訂正箇所とその説明
52	<p>図 3.3.16 370°C200rpm の凡例プロット 誤 : ▲ → 正 : △</p> <p>キャプション (<math>C_0</math>は各温度における溶質飽和濃度) ↓ (<math>C_s</math>は各温度における溶質飽和濃度)</p> 
63	本文左段 10 行目 誤 : 融点が 450°C以下 → 正 : 融点が 450°C未満
73	本文右段 11 行目 誤 : 3.4.1「ぬれ」で述べた → 正 : 3.3.1「ぬれ」で述べた
141	本文右段 4 行目 誤 : 1.2m×1.2m → 正 : 1m×1.2m
142	<p>図 7.2.1 縦軸の線の位置修正</p> 

頁	訂正箇所とその説明
144	<p>図 7.3.3</p> <p>(a) の② (b) のスルーホールめっきおよびソルダフィレット</p> <p>矢印の位置 修正</p> <p>(a) スルーホールめっき無し 片面プリント配線板</p> <p>(b) スルーホールめっき有り 両面プリント配線板</p>
144	<p>図 7.3.5</p> <p>シルクスクリーン印刷部</p> <p>矢印の位置 修正</p> <p>搬送方向</p> <p>シルクスクリーン印刷部</p>
150	<p>図 7.3.5 (a)および(b) 左側のランド部内 矢印追加</p> <p>0.2</p> <p>ランド部</p> <p>ソルダレジスト</p> <p>(a) 左右共ノーマルソルダレジスト</p> <p>(b) 左がノーマルソルダレジストで、 右がオーバーソルダレジスト</p>
164	<p>図 8.3.5 (b)</p> <p>図内の角度の数字</p> <p>修正</p> <p><math>15^{\circ} \sim 30^{\circ}</math></p> <p><math>30^{\circ} (45^{\circ})</math></p> <p><math>1.5 \pm 0.3</math></p>

頁	訂正箇所とその説明
172	<p>図 8.3.14 写真差し替え (b) 位置特定</p>  <p>(a) 糸引き (b) 飛び散り</p> <p>本文右段 9 行目 誤 : <u>プリント配線板</u>の入口 → 正 : <u>硬化炉</u>の入口</p>
192	<p>図 10.2.4 図差し替え</p>  <p>引張強さ (MPa) 伸び (%) 温度 (°C) 引張速度: <math>1.57 \times 10^{-2} (s^{-1})</math> 引張速度: <math>1.57 \times 10^{-2} (s^{-1})</math></p> <p>Legend: □ Sn-62In-38Bi ○ Sn-50In △ Sn-37Pb</p>
196	<p>本文左段 5 行目 誤 : 寿命 <math>N_f</math> (判断に至) → 正 : 寿命 <math>N_f</math> (破断に至)</p>
215	<p>図 11.3.1 のキャプション 誤 : <u>透過 X 線</u>の原理 → 正 : <u>ラミノグラフ型 X 線検査装置</u>の原理図</p>
223	<p>図 11.5.5 のキャプション 誤 : ひずみ速度の破壊モードへの効果 → 正 : 押圧せん断試験での破壊モードの変化</p>